Market News

Die neue XMC7000-Serie für industrielle Anwendungen bietet mehr Leistung, Speicher, eine verbesserte Peripherie sowie einen größeren Temperaturbereich

München – 9. November 2022 – Die Infineon Technologies AG stellt auf der electronica 2002 die XMC7000-Mikrocontroller (MCU)-Familie für anspruchsvolle industrielle Anwendungen vor. Hierzu gehören industrielle Antriebe, das Laden von Elektrofahrzeugen, Zweirad-Elektrofahrzeuge und Robotik. Die XMC7000-Serie bietet Single- und Dual-Core-Optionen mit einem 350-MHz 32-Bit Arm® Cortex®-M7 und einem 100-MHz 32-Bit Arm® Cortex®-M0+, bis zu 8 MB Embedded Flash und 1 MB On-Chip SRAM. Die Produkte arbeiten mit 2,7 bis 5,5 V und erreichen die volle Spezifikation von -40°C bis 125°C.

„Moderne Industrieausrüstung von heute erfordert eine höhere Rechenleistung und Peripherie, ohne dabei Abstriche bei Qualität und Robustheit in Kauf zu nehmen“, sagt Steve Tateosian, Vice President der IoT, Compute and Wireless Business Unit von Infineon. „Die neuen Bauteile der XMC7000-Serie von Infineon erfüllen diese Anforderungen, vor allem dank der Software- und Tool-Expertise des Unternehmens auf Systemebene für den industriellen Markt. Als führender Anbieter von Mikrocontrollern freuen wir uns, diese neue Familie für die industriellen Anwendungen von morgen mit innovativen Funktionen zu erweitern.“

Mit den neuen XMC7100 und XMC7200 MCUs ist die XMC7000-Familie eine Erweiterung der XMC-Familie, die speziell für industrielle Steuerungen entwickelt wurde. Der XMC7100 von Infineon verfügt über 4 MB Flash, 768 kB RAM und 250 MHz Single- oder Dual-Core in verschiedenen QFP-Gehäusen (100, 144 oder 176 Pins) oder 272-Pin-BGA-Gehäusen. Der XMC7200 enthält 8 MB Flash, 1 MB RAM, 350 MHz Single- oder Dual-Core in einem 176-Pin-QFP- oder 272-Pin-BGA-Gehäuse.

Über die XMC7000-Familie von Infineon

Die XMC7000-Bauteile sind die neuesten Produkte im industriellen Mikrocontroller-Portfolio von Infineon. Sie sind mit Peripheriegeräten wie CAN FD, TCPWM und Gigabit Ethernet ausgestattet, wodurch die Flexibilität erhöht und dem Entwickler ein Mehrwert geboten wird. Die XMC7000-Architektur basiert auf einer

Für die Fachpresse
Informationsnummer INFCSS202211.021d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Fabian Schiffer
Tel.: +49 89 234-25869
fabian.schiffer@infineon.com

Investor Relations:
Tel.: +49 89 234-26655
investor.relations@infineon.com

energieeffizienten, robusten 40 nm Embedded Flash-Prozess-Technologie und bietet eine erstklassige Rechenleistung für industrielle High-End-Anwendungen.

Die neue MCU-Familie von Infineon bietet sowohl Single- als auch Dual-Core-Arm® Cortex®-M7-Optionen, die von einem Arm® Cortex®-M0+ unterstützt werden. Damit können Entwickler ihre Endprodukte so optimieren, dass sie die dynamischen und anspruchsvollen Bedingungen industrieller Anwendungen erfüllen. Aufgrund der fortschrittlichen Peripherie und der robusten Sicherheitsfunktionen ist die Produktfamilie insbesondere für Kunden interessant, die eine hochwertige MCU-Plattform benötigen. Die Bauteile können in rauen Umgebungen mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 125°C betrieben werden und eignen sich aufgrund ihres niedrigen Energiebedarfs von nur 8 µA im Standby-Modus auch ideal für energiekritische Anwendungen. Der flexible XMC7000 ist in vier Gehäuse- und Pin-Typen mit 17 Teilenummernvarianten erhältlich und erfüllt damit verschiedene Designanforderungen.

Die XMC7000-Bauteile sind mit der aktuellen ModusToolbox™ 3.0-Entwicklungsplattform von Infineon kompatibel und bieten ein einzigartiges Nutzererlebnis für eine Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter Industrie-, Robotik-, EV-Lade- und andere Anwendungen. Die ModusToolbox 3.0 von Infineon ist nicht nur mit dem XMC7000 kompatibel, sondern auch mit Embedded-Anwendungen, die Infineon-Produkte wie PSoC™, AIROC™ Wi-Fi, AIROC Bluetooth® und EZ-PD™ PMG1-Mikrocontroller verwenden. ModusToolbox 3.0 kann hier heruntergeladen werden.

Verfügbarkeit

Die XMC700-Familie von Infineon ist ab sofort erhältlich und wird auf der electronica 2022 zu sehen sein. Weitere Informationen über die komplette Lösung sind erhältlich unter www.infineon.com/XMC7000.

Mehr Informationen zum Beitrag von Infineon im Bereich Energieeffizienz: www.infineon.com/green-energy

Infineon auf der electronica 2022

Auf der diesjährigen Fachmesse electronica in München präsentiert Infineon Lösungen für die großen Herausforderung unserer Zeit. Halbleiter tragen auf vielfältige Weise zur grünen und digitalen Transformation bei und sind das Herzstück

Für die Fachpresse
Informationsnummer INFCSS202211.021d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Fabian Schiffer
Tel.: +49 89 234-25869
fabian.schiffer@infineon.com

Investor Relations:
Tel.: +49 89 234-26655
investor.relations@infineon.com

jeder vernetzten Anwendung. Auf der electronica 2022 macht Infineon nun deutlich, warum sie auch Schlüsselelemente für eine bessere Zukunft sind und wie sie den Weg zur Klimaneutralität ebnen. In Halle C3, Stand 502 stellt das Unternehmen vom 15. bis 18. November intelligente und energieeffiziente Lösungen für die vernetzte Welt von morgen vor, unter dem Motto: „Driving decarbonization and digitalization. Together." Mehr Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/electronica.

Für die Fachpresse
Informationsnummer INFCSS202211.021d

Infineon Technologies AG
Media Relations:
Fabian Schiffer
Tel.: +49 89 234-25869
fabian.schiffer@infineon.com

Investor Relations:

Tel.: +49 89 234-26655
investor.relations@infineon.com